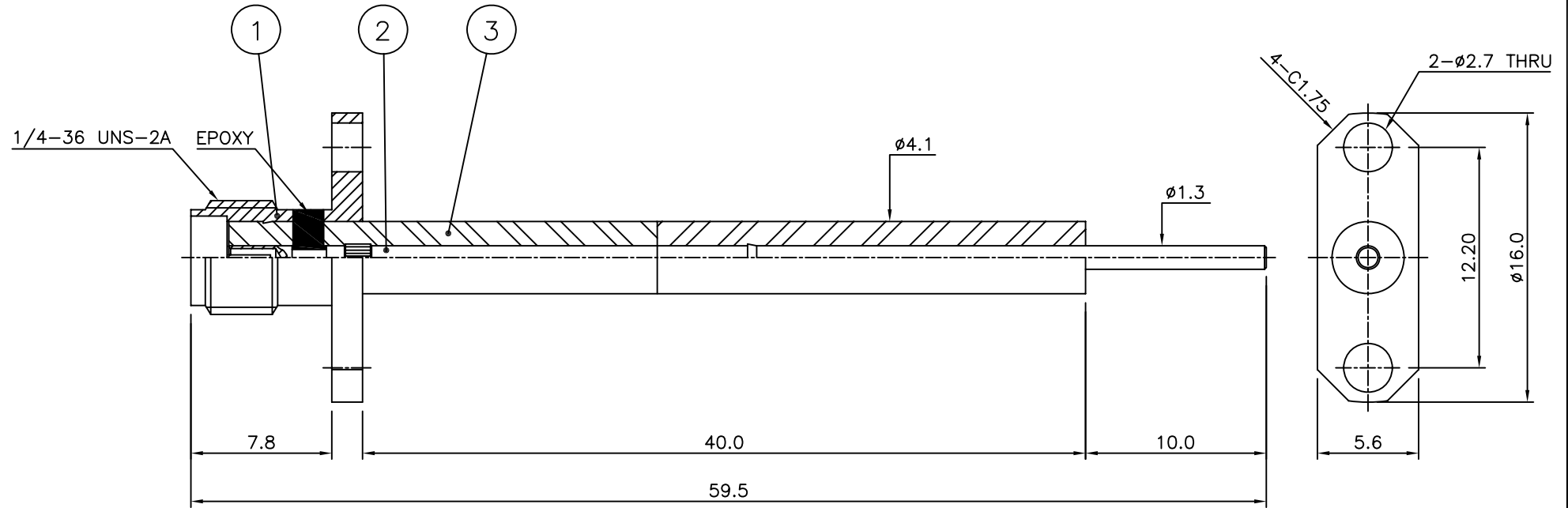


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM		2016.12.14.



조립순서 및 방법

1. ①번 BODY에 ③번 절연체(1)를 조립한다.
2. BODY+절연체 조립후 $\phi 1.7$ 드릴 관통시킨다. - *BURR 제거 할 것.
3. ②번 PIN을 BODY에 조립 후 ③번 절연체(2)를 PIN에 조립한다.
(SMA PIN 높이 JIG 사용 할 것)
4. EPOXY작업을 한다.

3	INSULATOR	2	TEFLON		DIN02861-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT03794-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD02962-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2016. 12. 14.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY		
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE SMA50 SOLDER END JS-2H
		DRAWN BY	I.C.KIM	
FINISH		SCALE	UNIT	A4 DWG NO. CN02910-7/4 REVISION I R SHEET 1 of 1
		3/1	mm	